

**Family list**

1 application(s) for: JP2003318133

<b>1</b>	<p><b>FORMING METHOD FOR FILM PATTERN, FILM PATTERN FORMING DEVICE, CONDUCTIVE FILM WIRING METHOD, MOUNT STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR CHIP, SEMICONDUCTOR APPARATUS, LIGHT EMISSION DEVICE, ELECTRONIC OPTICAL APPARATUS, ELECTRONIC APPARATUS, AND NON-CONTACT CARD MEDIUM</b></p> <p>Inventor: KUROSAWA HIROFUMI ; HASEI  HIRONOBU (+1)</p> <p>EC:</p> <p>Publication JP2003318133 (A) - 2003-11-07  info:</p>	<p>Applicant: SEIKO EPSON CORP</p> <p>IPC: H01L21/288; H01L21/31; H01L21/3205; (+9)</p> <p>Priority Date: 2002-04-22</p>
----------	--	--

---

Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

**FORMING METHOD FOR FILM PATTERN, FILM PATTERN FORMING DEVICE, CONDUCTIVE FILM WIRING METHOD, MOUNT STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR CHIP, SEMICONDUCTOR APPARATUS, LIGHT EMISSION DEVICE, ELECTRONIC OPTICAL APPARATUS, ELECTRONIC APPARATUS, AND NON-CONTACT CARD MEDIUM**

Publication number: JP2003318133 (A)

Publication date: 2003-11-07

Inventor(s): KUROSAWA HIROFUMI; HASEI HIRONOBU; AOKI TAKASHI +

Applicant(s): SEIKO EPSON CORP +

Classification:

- International: H01L21/288; H01L21/31; H01L21/3205; H01L21/336; H01L29/786; H01L21/02; H01L29/66; (IPC1-7): H01L21/288; H01L21/31; H01L21/3205; H01L21/336; H01L29/786

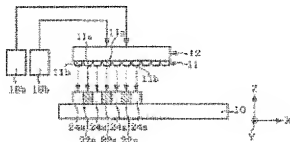
- European:

Application number: JP20020119573 20020422

Priority number(s): JP20020119573 20020422

**Abstract of JP 2003318133 (A)**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a forming method for a film pattern, a film pattern forming device, a conductive film wiring method, the mount structure of a semiconductor chip, a semiconductor apparatus, a light emission device, an electronic optical apparatus, an electronic apparatus, and a non-contact card medium, which are capable of forming high precise film pattern with a simple process. ; **SOLUTION:** The forming method for the film pattern forms the film pattern with a droplet discharging method discharging a droplet consisting of a liquid substance including a film forming component to a prescribed film forming area on a substrate. A plurality of film patterns are formed at adjacent positions by discharging a plurality of droplets mutually free from mixture. ; **COPYRIGHT:** (C)2004,JPO



Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-318133

(P2003-318133A)

(43) 公開日 平成15年11月7日 (2003. 11. 7)

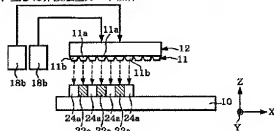
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-ロ-ド <sup>*</sup> (参考)
H 0 1 L	21/288	H 0 1 L 21/288	Z 4 M 1 0 4
	21/31	21/31	A 5 F 0 3 3
	21/3205	29/78	6 1 6 K 5 F 0 4 5
	21/336		6 1 7 J 5 F 1 1 0
	29/786	21/88	B
審査請求 未請求 請求項の数25 O L (全 24 頁) 最終頁に続く			
(21) 出願番号	特願2002-119573(P2002-119573)	(71) 出願人	00002369 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
(22) 出願日	平成14年 4 月22日 (2002. 4. 22)	(72) 発明者	黒沢 弘文 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
		(72) 発明者	長谷井 宏宣 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
		(74) 代理人	100090479 弁理士 井上 一 (外 2 名)
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 膜パターンの形成方法、膜パターン形成装置、導電膜配線、半導体チップの実装構造、半導体装置、発光装置、電気光学装置、電子機器、並びに非接触型カード媒体

(57) 【要約】

【課題】 簡便な工程にて高精度の膜パターンを形成することが可能な膜パターンの形成方法および膜パターン形成装置、ならびに導電膜配線、半導体チップの実装構造、半導体装置、発光装置、電気光学装置、電子機器、並びに非接触型カード媒体を提供する。

【解決手段】 本発明の膜パターンの形成方法は、液滴吐出法によって、膜形成成分を含有した液状物からなる液滴を、基板上の所定の膜形成領域に吐出して膜パターンを形成する膜パターンの形成方法であって、互いに混ざり合わない複数の液滴を吐出することにより、隣り合う位置に複数の膜パターンを形成することを含む。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液滴吐出法によって、膜形成成分を含有した液状物からなる液滴を、基板上の所定の膜形成領域に吐出して膜パターンを形成する膜パターンの形成方法であって、

互いに混ざり合わない複数の液滴を吐出することにより、隣り合う位置に複数の膜パターンを形成する、ことを含む、膜パターンの形成方法。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記隣り合う位置に形成される前記複数の膜パターンは、互いに異なる機能を有する、膜パターンの形成方法。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 において、前記複数の液滴を、前記基板と平行な方向に隣り合う位置に吐出することにより、前記複数の膜パターンを、前記基板と平行な方向に隣り合うように形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項 4】 請求項 1 または 2 において、前記複数の液滴をほぼ同一位置に重ねて吐出することにより、前記複数の膜パターンを、前記基板と垂直方向に隣り合うように形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項 5】 請求項 4 において、前記複数の液滴のうち 1 の液滴を構成する液状物は、前記 1 の液滴よりも上部に形成された液滴を構成する液状物よりも沸点が低い、膜パターンの形成方法。

【請求項 6】 請求項 4 または 5 において、前記複数の液滴は、前記基板に設けられた凹部に吐出することにより、前記複数の膜パターンを該凹部に形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項 7】 請求項 6 において、前記複数の液滴を前記凹部に吐出した後、該複数の液滴に遠心力を付加することにより、該複数の液滴の分離を促進させること、を含む、膜パターンの形成方法。

【請求項 8】 請求項 1 ないし 7 のいずれかにおいて、前記複数の液滴は、第 1 の液滴と第 2 の液滴からなり、前記第 1 の液滴は、膜形成成分として導電性微粒子を含む液状物であり、前記第 2 の液滴は、前記膜形成成分として絶縁体を含む液状物である、膜パターンの形成方法。

【請求項 9】 請求項 8 において、前記第 1 の液滴から導電膜を形成し、前記第 2 の液滴から絶縁膜を形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項 10】 請求項 9 において、前記第 1 の液滴に対して熱処理および/または光照射を行なうことにより、前記導電膜を形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項 11】 請求項 1 ないし 10 のいずれかにおいて、さらに、親液パターンおよび撥液パターンを、前記基板の所定領域に形成すること、を含む、

前記複数の液滴を、前記親液パターンおよび前記撥液パターンが施された領域に吐出することにより、前記複数の膜パターンを、該親液パターンの上に形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項 12】 請求項 1 ないし 11 のいずれかにおいて、

前記複数の液滴にそれぞれ含まれる液状物を、蒸発および/または分解によって同時に除去することにより、前記複数の膜パターンの界面を、大気に曝すことなく形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項 13】 液滴吐出法によって、膜形成成分を含有した液状物からなる液滴を、基板上の所定の膜形成領域に吐出して膜パターンを形成する膜パターンの形成装置であって、

請求項 1 ないし 12 のいずれかに記載の膜パターンの形成方法によって膜パターンを形成する、膜パターンの形成装置。

【請求項 14】 請求項 13 において、前記複数の液滴を吐出することができる 1 のヘッドを含む、膜パターンの形成装置。

【請求項 15】 請求項 13 において、前記複数の液滴を構成する各液滴毎に専用のヘッドが設置されている、膜パターンの形成装置。

【請求項 16】 請求項 13 において、前記複数の液滴を混合する混合手段を含み、該混合手段によって該複数の液滴を混合した後吐出する、膜パターンの形成装置。

【請求項 17】 請求項 8 ないし 10 のいずれかに記載の膜パターンの形成方法によって形成される、導電膜配線。

【請求項 18】 請求項 17 に記載の導電膜配線を含む、半導体チップの実装構造。

【請求項 19】 請求項 17 に記載の導電膜配線を含む、電気光学装置。

【請求項 20】 ソース電極、ドレイン電極、およびゲート電極と、前記電極を互いに絶縁する絶縁層と、を含み、前記電極および前記絶縁層が、請求項 1 に記載の膜パターンの形成方法を経て形成される、半導体装置。

【請求項 21】 発光層および正孔輸送/注入層と、該発光層および該正孔輸送/注入層を挟持する一対の電極層と、を含み、前記発光層および前記正孔輸送/注入層が、請求項 1 ないし 7 のいずれかに記載の膜パターンの形成方法を経て形成される、発光装置。

【請求項 22】 請求項 19 に記載の電気光学装置を含む、電子機器。

【請求項 23】 請求項 20 に記載の半導体装置を含む、電子機器。

【請求項 24】 請求項 21 に記載の発光装置を含む、

電子機器。

【請求項25】 請求項17に記載の導電膜配線をアンテナ回路として含む、非接触型カード媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、電極、アンテナ、電子回路、集積回路などの配線に使用される導電膜配線、ならびに該導電膜配線を保護する絶縁膜等の膜パターンの形成方法および膜パターン形成装置に関する。

【0002】 また、本発明は、電気光学装置を構成する各層を形成するための膜パターンの形成方法および膜パターン形成装置に関する。

【0003】 さらに、本発明は、半導体チップの実装構造、半導体装置、発光装置、電気光学装置、電子機器、並びに非接触型カード媒体に関する。

【0004】

【背景技術】 インクジェット法にて、所定の材料を基板上に吐出して、各種の電気光学装置に含まれる配線や層を所定のパターンに形成する方法が開発されている。例えば、米国特許5132248号では、導電性微粒子を分散させた液状物をインクジェット法にて基板上に直接パターン塗布し、その後熱処理やレーザ照射を行なって導電膜パターンに変換する方法が提案されている。この方法によれば、配線形成のプロセスが大幅に簡単なものになるとともに、原材料の使用量も少なくてすむというメリットがある。

【0005】 ところで、近年の素子の微細化に伴い、各種の電気光学装置に含まれる配線や絶縁層が微細化されている。なかでも、電子回路や電極、集積回路に用いられる配線は、微細化されるにたがひ、隣接する配線同士が接触してショートする可能性が大きくなる。したがって、精度良く配線パターンニングすることにより、配線間の絶縁性を確保することが重要となる。

【0006】 一方、発光装置、例えば有機EL装置を形成する場合、有機EL装置を構成する複数の層（例えば発光層と正孔輸送／注入層等）を、インクジェット法にて形成することができる。この場合、一般に、複数の異なる材料を順に塗布していく。この有機EL装置が駆動される際、有機EL装置を構成する前記複数の層の間で電荷（正孔または電子）が移動する。高効率の有機EL装置を得るためには、これらの層の間における電荷の移動性を高めることが重要である。これらの層の界面が均質に形成されていることにより、電荷の移動性を高めることができる。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、簡易な方法で形成が可能であり、かつ、高精度の膜パターンの形成方法および膜パターン形成装置を提供することにある。

【0008】 また、本発明の目的は、発光装置または半

導体装置を構成する各層を形成するための膜パターンの形成方法および膜パターン形成装置、ならびに該膜パターンの形成方法によって形成された発光装置および半導体装置に関する。

【0009】 さらに、本発明は、前記膜パターンの形成方法によって形成された導電膜配線、および該導電性配線を含む半導体チップの実装構造、電気光学装置、電子機器、並びに非接触型カード媒体に関する。

【0010】

【課題を解決するための手段】（膜パターンの形成方法） 本発明の膜パターンの形成方法は、液滴吐出法によって、膜形成成分を含有した液状物からなる液滴を、基板上の所定の膜形成領域に吐出して膜パターンを形成する膜パターンの形成方法であって、互いに混ざり合わない複数の液滴を吐出することにより、隣り合う位置に複数の膜パターンを形成することを含む。

【0011】 本発明の膜パターンの形成方法によれば、隣り合う位置に複数の膜パターンを精度良くかつ簡易な方法により形成することができる。詳しくは、本実施の形態の欄で説明する。

【0012】 本発明の膜パターンの形成方法は、（1）～（6）の態様をとることができる。

【0013】（1）前記隣り合う位置に形成される前記複数の膜パターンは、互いに異なる機能を有することができる。この方法によれば、互いに機能が異なる複数の膜パターンを同時に形成することができるため、製造プロセスの工程の効率化を図ることができる。さらに、前記複数のパターンをそれぞれ所望の形状に形成することができる。

【0014】（2）前記複数の液滴を、前記基板と平行な方向に隣り合う位置に吐出することにより、前記複数の膜パターンを、前記基板と平行な方向に隣り合うように形成することができる。

【0015】（3）前記複数の液滴をほぼ同一位置に重ねて吐出することにより、前記複数の膜パターンを、前記基板と垂直方向に隣り合うように形成することができる。

【0016】この場合、前記複数の液滴のうち1の液滴を構成する液状物を、前記1の液滴より上部に形成された液滴を構成する液状物よりも沸点が低くすることができる。この方法によれば、前記1の液滴を構成する液状物をより容易に除去することができる。

【0017】また、この場合、前記複数の液滴を、前記基板に設けられた凹部に吐出することにより、前記複数の膜パターンを該凹部に形成することができる。この際、前記複数の液滴を前記凹部に吐出した後、該複数の液滴に満力度を付加することにより、該複数の液滴の分離を促進させること、を含むことができる。この方法によれば、該複数の液滴が容易に分離されて、短時間で膜質の均一化を図ることができる。

【0018】（４）前記複数の液滴は、第１の液滴と第２の液滴からなり、前記第１の液滴は、前記膜形成成分として導電性微粒子を含む液状物であり、前記第２の液滴は、前記膜形成成分として絶縁体を含む液状物であることができる。この方法によれば、導電膜とともに絶縁膜を形成することができる。また、導電膜を精度良くかつ簡便な方法により形成することができるため、断線や短絡等の不良が生じにくく、信頼性に優れた導電膜配線を得ることができる。

【0019】この場合、前記第１の液滴から導電膜を形成し、前記第２の液滴から絶縁膜を形成することができる。この方法によれば、導電膜とともに絶縁膜を形成することができるため、製造プロセスの工程の効率化を図ることができる。

【0020】また、この場合、前記第１の液滴に対して熱処理および／または光照射を行なうことにより、前記導電膜を形成することができる。この方法によれば、簡易な方法にて第１の液滴に含まれる膜形成成分を固化させることができる。

【0021】（５）さらに、親液パターンおよび撥液パターンを、前記基板の所定領域に形成すること、を含み、前記複数の液滴を、前記親液パターンおよび前記撥液パターンが施された領域に吐出することにより、前記複数の膜パターンを、該親液パターンの上に形成することができる。この方法によれば、前記複数の膜パターンを形成したい領域に前記親液パターンを形成しておくことにより、該複数の膜パターンを所望の領域に選択的に形成することができるため、所望の形状の膜パターンを形成することができる。

【0022】例えば、前記複数の液滴を所望の領域に塗布するための基板処理をあらかじめ行う場合、例えば、UVを照射することによって基板を撥液化したり、例えばヘキサデカフルオロ－１，１，２，２テトラヒドロシルトリエトキシシランや、トリデカフルオロ－１，１，２，２テトラヒドロオクチルトリエトキシシランなどに代表されるフルオロアルキルシラン（FAS）を用いて基板を撥液化し、このFASへのUVのパターン照射によって所望の位置だけ撥液化することによって前記親液パターンおよび前記撥液パターンを作成することができる。これにより、膜パターンを精度良く形成することができる。

【0023】（６）前記複数の液滴にそれぞれ含まれる液状物を、蒸発および／または分解によって同時に除去することにより、前記複数の膜パターンの界面を、大気に曝すことなく形成することができる。この方法によれば、前記複数の膜パターンの界面を良好な状態に形成することができるため、膜パターンの機能を高めることができる。

【0024】（膜パターンの形成装置）本発明の膜パターンの形成装置は、液滴吐出法によって、膜形成成分を

含有した液状物からなる液滴を、基板上の所定の膜形成領域に吐出して膜パターンを形成する膜パターンの形成装置であって、上記膜パターンの形成方法によって膜パターンを形成する。

【0025】本発明の膜パターンの形成装置によれば、隣り合う位置に複数の膜パターンを精度良くかつ簡単に形成することができる。

【0026】上記膜パターンの形成装置は、前記複数の液滴を吐出することができる１のヘッドを含むことができる。また、前記複数の液滴を構成する各液滴毎に専用のヘッドが設置できる。さらに、前記複数の液滴を混合する混合手段を含み、該混合手段によって該複数の液滴を混合した後吐出することができる。

【0027】（導電膜配線および半導体チップの実装構造および電気光学装置）本発明の導電膜配線は、上記本発明の膜パターンの形成方法によって形成される。また、本発明の半導体チップの実装構造ならびに本発明の電気光学装置は、上記本発明の導電膜配線を含む。

【0028】本発明の導電膜配線によれば、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ微細化された導電膜配線を得ることができる。

【0029】（半導体装置）本発明の半導体装置は、ソース電極、ドレイン電極、およびゲート電極と、前記電極を互いに絶縁する絶縁層と、を含み、前記電極および前記絶縁層が、上記本発明の膜パターンの形成方法を経て形成される。

【0030】（発光装置）本発明の発光装置は、発光層および正孔輸送／注入層と、該発光層および該正孔輸送／注入層を挟持する一対の電極層と、を含み、前記発光層および前記正孔輸送／注入層が、上記本発明の膜パターンの形成方法を経て形成される。

【0031】（電子機器および非接触型カード媒体）本発明の電子機器は、上記本発明の電気光学装置、上記本発明の半導体装置、および／または上記本発明の発光装置を含む。また、本発明の非接触型カード媒体は、上記本発明の導電膜配線をアンテナ回路として含む。

【0032】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0033】【第１の実施の形態】第１の実施の形態として、本発明の膜パターン形成方法の一例である導電膜配線の形成方法について説明する。なお、本発明において、液滴吐出法とは、液滴を所望のパターンに吐出することにより、基板上に所望のパターンを有する材料物質を形成する方法であり、インクジェット法と呼ばれることもある。但しこの場合、吐出する液滴は、印刷物に用いられる所謂インクではなく、デバイスを構成する材料物質を含む液状体であり、この材料物質は、例えばデバイスを構成する導電物質または絶縁物質として機能し得る物質を含むものである。さらに、液滴吐出とは、吐出

時に噴霧されるものに限らず、液状体の1滴1滴が連続して塗布される場合も含む。

【0034】図1は、本発明を適用した第1の実施の形態に係る膜パターンの形成方法を模式的に示す断面図であり、図2は、第1の実施の形態に係る膜パターンの形成方法によって形成された膜パターンを模式的に示す平面図である。なお、図1に示されている基板10は、図2のA-Aに沿った断面に相当する。

【0035】本実施の形態に係る配液形成方法は主に、第1および第2の液滴22a、24aの吐出工程と、固化工程を含む。以下、各工程について説明する。

【0036】（吐出工程）吐出工程においては、液滴吐出法によって、膜形成成分を含む液状物からなる液滴を、基板上の所定の膜形成領域に吐出して膜パターンを形成する膜パターンの形成方法であって、導電性微粒子を含む液状物（第1の液滴）と、絶縁体を含む液状物（第2の液滴）とを吐出する。本実施の形態においては、この導電性微粒子を含む液状物（第1の液滴22a）と、絶縁体を含む液状物（第2の液滴24a）とは、互いに混ざり合わない性質を有する。

【0037】本実施の形態においては、図1に示すように、導電性微粒子を含む液状物（第1の液滴22a）を吐出するノズル11aと、絶縁体を含む液状物（第2の液滴24a）を吐出するノズル11bとを交互に設置したインクジェットヘッド12を用いる。このインクジェットヘッド12を、図1に示すY方向に移動させながら、第1の液滴22aと第2の液滴24aとを、基板10と平行な方向（図1のX方向）に隣り合う位置に吐出することにより、基板10上へ向けて（図1に示すZ方向へ）これらの液滴を着弾させる。これにより、第1の液滴22aと第2の液滴24aが図1のX方向に交互に配置され、かつ、図1および図2のY方向に延びるパターンが形成される（図2参照）。

【0038】導電性微粒子を含む液状物（第1の液滴22a）および絶縁体を含む液状物（第2の液滴24a）の材質としては、互いに混ざり合わないものであれば特に限定されない。

【0039】導電性微粒子を含む液状物としては、導電性微粒子を液状物（分散液）に分散させた液状物（分散液）を用いる。ここで用いられる導電性微粒子は、金、銀、銅、パラジウム、ニッケルの何れかを含有する金属微粒子の他、導電性ポリマーや超伝導体の微粒子などが用いられる。

【0040】これらの導電性微粒子は、分散性を向上させるために、表面に有機物をコーティングして使用するこもできる。導電性微粒子の表面にコーティングするコーティング材としては、例えばゼラチンやポリビニルアルコール等の高分子材料やクエン酸などが例示できる。

【0041】使用する分散媒としては、上記の導電性微

粒子を分散できるもので、凝集を起こさないものであれば特に限定されない。

【0042】絶縁体を含む液状物としては、絶縁体を分散媒に分散させた液状物、あるいは絶縁体を溶媒に溶解させて得られた液状物を用いる。ここで用いられる絶縁体の材質は、特に限定されるわけではなく、酸化シリコンや酸化シリコンなどの無機物、あるいはポリアリル樹脂やエポキシ樹脂などの有機物を用いることができる。

【0043】第1の液滴22aと第2の液滴24aの組み合わせとしては、例えば第1の液滴22aとして粒子分散液（アルバック社製；商品名パーフェクトシルバー（主溶剤：トルエン））を用い、第2の液滴24aとして屈折成工業（株）製バイメタル（主溶剤：N-メチル-2-ピロリドン）を用いることができる。あるいは、例えば第1の液滴22aとして、前記導電性微粒子をフェノール樹脂やエポキシ樹脂に分散させ、必要に応じて溶剤や硬化剤、分散剤、酸化防止剤などを混合したものを、第2の液滴24aとしてエポキシ樹脂等を主成分とするソルダーレジストを用いることができる。この場合、フェノール樹脂やエポキシ樹脂は熱処理および/または光照射によって硬化させることができる。

【0044】また、配線を形成すべき基板としては、Siウエハ、石英ガラス、ガラス、プラスチックフィルム、金属板など各種のものを用いることができる。また、これら各種の素材基板の表面に半導体膜、金属膜、誘電体膜、有機膜などが下層として形成されたもの、を、配線を形成すべき基板として用いることもできる。

【0045】（固化工程）次に、基板10上に第1および第2の液滴22a、24aを吐出した後、これらの液滴に含まれる分散媒や溶媒の除去等を行うことにより、第1および第2の液滴22a、24aそれぞれに含まれる膜形成成分の固化を行なう。

【0046】固化工程は、例えば、第1の液滴22aおよび第2の液滴24aに対して熱処理および/または光照射を行なうことにより行なわれる。この工程により、導電膜22および絶縁膜24が形成される。例えば、熱処理により、第1の液滴22aおよび/または第2の液滴24aに含まれる液状物が蒸発および/または分解することにより、前記液滴から液状物を除去することにより、前記液滴に含まれる膜形成成分が固化し、導電膜22および絶縁膜24が形成される。あるいは、例えば、光照射により、第1の液滴22aおよび/または第2の液滴24aに含まれる膜形成成分が固化（硬化）して、導電膜22および絶縁膜24が形成される。この方法によれば、簡易な方法にて第1の液滴および第2の液滴に含まれる膜形成成分をそれぞれ固化させることができる。

【0047】第1の液滴22aおよび第2の液滴24aに対して熱処理を行ない、導電膜22および絶縁膜24を形成する場合、例えば基板10を加熱する通常のホッ

トプレートや電気炉などによる処理の他、ランプアニールによって行うこともできる。ランプアニールに使用する光の光源としては特に限定されないが、赤外線ランプ、キセノンランプ、YAGレーザー、アルゴンレーザー、炭酸ガスレーザー、XeF、XeCl、XeBr、KrF、KrCl、ArF、ArClなどのエキシマレーザーなどを光源として用いることができる。

【0048】また、この場合、熱処理工程は吐出工程と平行し同時に進行させることも可能である。例えば、予め加熱しておいた基板10に前記液滴を吐出したり、インクジェットヘッド12（図1参照）を冷却して、沸点の低い分散媒を使用したりすることにより、基板10へ前記液滴が着弾した直後から蒸発を進行させることができる。以上の工程により、図1および図2に示すように、隣り合う位置に複数の膜パターン（導電膜22および絶縁膜24）を形成する。本実施の形態においては、複数の導電膜22および絶縁膜24が、基板10と平行な方向（ここではY方向）に交互に隣り合うように形成された例を示す。すなわち、図2に示すように、基板10上に、複数の導電膜22が絶縁膜24を介して配置されている。したがって、本実施の形態においては、隣り合う位置に形成された複数のパターン（導電膜22と絶縁膜24）は、互いに異なる機能を有する。この方法によれば、互いに機能が異なる複数の膜パターン（導電膜22と絶縁膜24）を同時に形成することができるため、製造プロセスの工程の効率化を図ることができる。加えて、導電膜22と絶縁膜24を、それぞれ所望の形状に形成することができる。

【0049】本実施の形態の膜パターン形成方法によれば、隣り合う位置に複数の膜パターンを精度良くかつ簡易な方法により形成することができる。

【0050】また、本実施の形態においては、膜パターン形成方法の一例として導電膜配線の形成方法が例示されている。この方法によれば、隣接する導電膜配線間の絶縁性を確保しつつ、断線や短絡等の不良が生じにくく、信頼性に優れた導電膜配線を、精度良くかつ簡便な方法により形成することができる。その理由について、以下に、インクジェット法を用いた一般的な導電膜配線の形成と比較しながら説明する。

【0051】インクジェット法を用いた一般的な導電膜配線の形成方法においては、図27に示すように、導電性材料を含む液滴（第1の液滴）を吐出し（S11）、次いで、固化工程により該液滴に含まれる分散媒（溶媒）を除去した後（S12）、膜質検査および位置合わせ工程を経て（S13、S14）、絶縁体を含む液滴（第2の液滴）を吐出し（S15）、次いで、固化工程により導電膜および絶縁膜を形成する（S16）。

【0052】これに対して、本実施の形態の導電膜配線の形成方法によれば、図26に示すように、導電性材料を含む液滴を吐出した後（S2）、続いて絶縁体を含む

液滴を吐出する（S3）。次いで、固化工程により、導電膜および絶縁膜を形成する（S4）。

【0053】以上に説明したように、本実施の形態の導電膜配線の形成方法によれば、導電膜とともに絶縁膜を形成することができるため、製造プロセスの工程の効率化を図ることができる。例えば、前記第1および第2の液滴に含まれる液状物（分散媒）を熱処理にて蒸発等させて除去する場合、前記液状物を除去する工程を一度で行うため、製造工程の簡略化を図ることができる。

【0054】さらに、本実施の形態の導電膜配線の形成方法によれば、微細な導電膜配線を精度良く形成することができる。

【0055】なお、以上に説明したように、本実施の形態においては、本発明の膜パターン形成方法の一例として配線形成方法について説明したが、本発明の膜パターンの形成方法は配線形成方法に限定されるわけではなく、液滴吐出法によって、互いに混ざり合わない複数の液滴を吐出することにより、隣り合う位置に複数の膜パターンを形成するものであれば、複数の液滴を構成する材料（複数の膜パターンを構成する材料）は特に限定されない。例えば、本発明の膜パターンの形成方法を用いて、有機EL装置を構成する各層（例えば発光層および正孔輸送/注入層）を形成することができる。また、本実施の形態においては、吐出する液滴は第1の液滴と第2の液滴の2種類の場合について説明したが、吐出する液滴は2種類以上であってもよい。なお、これらの点は、後述する第6および第9の実施の形態の膜パターン形成方法においても同様である。

【0056】【第2の実施の形態】第2の実施の形態では、本発明を適用した膜パターン形成装置の一例として、上記第1の実施の形態に係る配線形成方法を実施するための配線形成装置について説明する。なお、後述する他の実施形態においても、本実施の形態に係る膜パターン形成装置を同様に適用することができる。

【0057】図3は、本実施の形態にかかる配線形成装置の概略斜視図である。図3に示すように、配線形成装置100は、インクジェットヘッド群1と、インクジェットヘッド群1をX方向に駆動するためのX方向ガイド軸2と、X方向ガイド軸2を回転させるX方向駆動モータ3とを備えている。

【0058】また、基板Wを載置するための載置台4と、載置台4をY方向に駆動するためのY方向ガイド軸5と、Y方向駆動モータ6とを備えている。

【0059】また、X方向ガイド軸2とY方向ガイド軸5とが、各々所定の位置に固定される基台7を備え、その基台7の下部には、制御装置8を備えている。

【0060】さらに、クリーニング機構部14およびヒータ15とを備えている。

【0061】インクジェットヘッド群1は、導電性微粒子を含有する分散液と、絶縁体を含有する分散液とをそ



れぞれ、ノズル（吐出口）から吐出して所定間隔で基板に付与するインクジェットヘッドを備えている。このインクジェットヘッドは、導電性微粒子を含有する分散液と、絶縁体を含有する分散液とに対して、それぞれ専用のインクジェットヘッドを設置することができる。そして、これらのインクジェットヘッド各々から、制御装置8から供給される吐出電圧に応じて個別に分散液を吐出できるようになっている。なお、導電性微粒子を含有する分散液と、絶縁体を含有する分散液とを、同一のインクジェットヘッドによって吐出させるようにしてもよい。

【0062】インクジェットヘッド群1はX方向ガイド軸2に固定され、X方向ガイド軸2には、X方向駆動モータ3が接続されている。X方向駆動モータ3は、ステップモータ等であり、制御装置8からX方向の駆動パルス信号が供給されると、X方向ガイド軸2を回転させるようになっている。そして、X方向ガイド軸2が回転させられると、インクジェットヘッド群1が基板7に対してX軸または-X軸方向に移動するようになっている。

【0063】載置台4は、この配線形成装置100によって分散液を付与される基板Wを載置させるもので、この基板Wを基準位置に固定する機構を備えている。

【0064】載置台4はY方向ガイド軸5に固定され、Y方向ガイド軸5には、Y方向駆動モータ6、16が接続されている。Y方向駆動モータ6、16は、ステップモータ等を含む移動ユニットであり、制御装置8からY軸方向の駆動パルス信号が供給されると、Y方向ガイド軸5を解放させるようになっている。そして、Y方向ガイド軸5が解放させられると、載置台4が基板7に対してY軸または-Y軸方向に移動するようになっている。

【0065】クリーニング機構部14は、インクジェットヘッド群をクリーニングする機構を備えている。クリーニング機構部14は、Y方向の駆動モータ16によってY方向ガイド軸5に沿って移動するようになっている。クリーニング機構部14の移動も、制御装置8によって制御されている。

【0066】ヒータ15は、ここではランプアニールにより基板Wを熱処理する手段であり、基板上に吐出された液滴に含まれる溶状物の蒸発を行ない、導電膜または絶縁膜に変換するための熱処理を行なうようになっている。このヒータ15の電源の投入および遮断も制御装置8によって制御されるようになっている。なお、前記液滴を光照射により固化させる場合は、ヒータ15のかわりに、光照射装置を設置することができる。

【0067】本実施の形態の配線形成装置100において、所定の配線形成領域に分散液を吐出するためには、制御装置8からの所定の駆動パルス信号をX方向駆動モータ3および/またはY方向駆動モータ6とに供給し、

インクジェットヘッド群1および/または載置台4を移動させることにより、インクジェットヘッド群1と基板W（載置台4）とを相対移動させる。そして、この相対移動の間にインクジェットヘッド群1における所定のインクジェットヘッドに制御装置8からの吐出電圧を供給し、当該インクジェットヘッドから分散液を吐出させる。

【0068】本実施の形態の配線形成装置100において、インクジェットヘッド群1の各ヘッドからの液滴の吐出量は、制御装置8から供給される吐出電圧の大きさによって調整できる。

【0069】また、基板Wに吐出される液滴のピッチは、インクジェットヘッド群1と基板W（載置台4）とび相対移動速度およびインクジェットヘッド群1からの吐出周波数（吐出電圧供給の周波数）によって決定される。

【0070】本実施の形態の膜パターン形成装置によれば、隣り合う位置に複数の膜パターンを精度良くかつ簡易に形成することができる。

【0071】〔第3の実施の形態〕第3の実施の形態では、本発明を適用した導電膜配線の一例について説明する。

【0072】図4は、本発明を適用した第3の実施の形態に係る導電膜配線を模式的に示す平面図である。なお、図4においては、配線間に形成された絶縁膜24（図5（a）参照）の図示は省略されている。図5（a）は、図4に示す領域Bの拡大模式図であり、図5（b）は、図5（a）のC-Cに沿った断面を模式的に示す図である。

【0073】本実施の形態においては、第1の実施の形態の配線形成方法によって得られる導電膜22および絶縁膜24を、半導体ICチップ30の再配置配線に適用した場合について説明する。また、この導電膜22および絶縁膜24は、第2の実施の形態の配線形成装置によって形成することができる。

【0074】半導体ICチップ30には、図4に示すように、外縁部近傍に形成された端子34と、この端子34よりも内側に形成された再配置端子32とが形成されている。この端子34と再配置端子32とは、配線（導電膜配線）22によって電気的に接続されている。すなわち、この導電膜22が再配置配線として機能する。

【0075】この半導体ICチップ30には、例えば領域Bのように、導電膜22が密に形成されている部分が存在する。本実施の形態の導電膜配線は、第1の実施の形態の配線形成方法によって、第2の実施の形態の配線形成装置を用いて形成されるため、隣り合う導電膜22間に絶縁膜24を配置することによって絶縁性を確保することができる（図5（a）および図5（b）参照）。これにより、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ微細化された導電膜配線

を得ることができる。

【0076】第4の実施の形態 第4の実施の形態では、本発明を適用した導電膜配線の一部について説明する。図6(d)は本発明を適用した第4の実施の形態に係る導電膜配線を模式的に示す断面図であり、図6(a)～図6(c)はそれぞれ、図6(d)に示す導電膜配線の製造工程を模式的に示す断面図である。

【0077】本実施の形態においては、第1の実施の形態の配線形成方法によって得られる導電膜22を、プリント基板40の多層配線に形成した場合について説明する。また、この導電膜22は、第2の実施の形態の配線形成装置によって形成することができる。

【0078】プリント基板40には、図6(d)に示すように、導電層42が形成されたベース基板41の上に、複数の配線層(導電膜22)が多層(図6(d)においては6層)積層されている。このベース基板41の上に導電膜22が多層積層されている。X方向に隣り合う導電膜22の間には、絶縁膜24が配設されている。本実施の形態で用いる絶縁膜24の材質としては、ポリイミド樹脂を例示することができる。

【0079】このプリント基板40を製造するために、図6(a)～図6(c)に示すように、第1の実施の形態の配線形成方法と同様の方法にて、液滴吐出法にて第1および第2の液滴22a、24aを所定の位置に吐出して、1層ずつ層を積層していく、複数の配線層を形成する。所定の層を積層した後、前記液滴に含まれる分散媒や溶媒の除去を行ない、第1および第2の液滴22a、24aそれぞれに含まれる膜形成成分の固化を行なう。固化は、第1の実施の形態の欄で説明した方法を用いることができる。以上の工程により、図6(d)に示すプリント基板40が得られる。

【0080】なお、本実施の形態では、形成すべき配線層をすべて形成した後、溶媒等の除去を行なって各層を固化する場合について説明したが、導電膜22および絶縁膜24からなる配線層を1層または数層形成する毎に溶媒等の除去等を行なうことにより、膜形成成分の固化を行なってもよい。

【0081】本実施の形態によれば、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ微細化された多層配線を得ることができる。

【0082】第5の実施の形態 第5の実施の形態では、本発明を適用した半導体装置の実装構造の一部について説明する。図7は、本発明を適用した半導体装置の実装構造の一例たる第5の実施の形態に係るCPIU搭載基板50を模式的に示す断面図である。

【0083】第5の実施の形態に係るCPIU搭載基板50は、図7に示すように、第4の実施の形態に係るプリント基板40を備えている。プリント基板40の上には、CPIU58が搭載されている。このCPIU58は、ボールパンプ53を介してプリント基板40と電気的に

接続されている。CPIU58の上には緩衝材56が配置されている。この緩衝材56は放熱材としても機能し、CPIU58の上にはこの緩衝材56を介してカバー58が配置されている。

【0084】本実施の形態によれば、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ微細化されたCPIU搭載基板を得ることができる。

【0085】第6の実施の形態 第6の実施の形態として、本発明の膜パターン形成方法の一例である導電膜配線形成方法について説明する。図8(a)は、本発明を適用した第6の実施の形態に係る膜パターンの形成方法を模式的に示す断面図である。図8(b)は、第6の実施の形態に係る膜パターンの形成方法によって形成された膜パターンを模式的に示す平面図である。なお、図8(b)は、図8(c)のE-Eに沿った断面に相当する。

【0086】本実施の形態においては、複数の液滴をほぼ同一位置に重ねて吐出することにより、複数の膜パターンを、基板と垂直方向に隣り合うように形成する場合について説明する。具体的には、導電性微粒子を含む液状物(第1の液滴62a)と、絶縁体を含む液状物(第2の液滴64a)とを、ほぼ同一位置に重ねて吐出する。その後、溶媒等を除去することにより膜形成成分を固化し、導電膜62と絶縁膜64とを基板10と垂直方向(図8(b)および図(c)に示すZ方向)に隣り合うように形成する。さらに、本実施の形態においては、導電膜62が絶縁膜64によって覆われるように形成される。また、隣り合う位置に形成された複数のパターン(導電膜62と絶縁膜64)は、互いに異なる機能を有する。

【0087】第1の液滴62aおよび第2の液滴64aはそれぞれ、第1の実施の形態の配線形成方法にて用いた第1の液滴22aおよび第2の液滴24aと同様の材質を用いることができる。

【0088】また、第1の液滴62aを構成する液状物を、第2の液滴64aを構成する液状物よりも沸点が低くすることができる。本実施の形態においては、第1の液滴62aよりも上部に第2の液滴64aが形成されているため、第1の液滴62aを構成する液状物として、第2の液滴64aを構成する液状物よりも沸点が低い材料を用いることにより、第1の液滴62aを構成する液状物を、より容易に除去することができる。

【0089】本実施の形態に係る配線形成方法は主に、第1および第2の液滴62a、64aの吐出工程と、固化工程を含む。このうち、固化工程については、第1の実施の形態の配線形成方法と同様であるため、本実施の形態においては、第1および第2の液滴62a、64aの吐出工程についてのみ説明する。

【0090】本実施の形態においては、図8(a)に示すように、導電性微粒子を含む液状物(第1の液滴62a)を吐出するノズル11aと、絶縁体を含む液状物(第2の液滴64a)を吐出するノズル11bとが隣接して設置されたインクジェットヘッド72を用いる。このインクジェットヘッド72を、図8(a)に示すY方向に移動させながら、第1の液滴62aと第2の液滴64aとを、ほぼ同一位置に重ねて吐出することにより、基板10上へ向けて(図8(b)および図(c)に示すZ方向へ)これらの液滴を着弾させる。より具体的には、第1の液滴62aを着弾させた直後に、第2の液滴64aを第1の液滴62aに重ねるように着弾させるのが好ましい。第1の液滴62aおよび第2の液滴64aは、互いに混ざり合わない物質からなるため、これらの液滴は互いに分離したままである。以上の工程により、第1の液滴62aと第2の液滴64aが基板10と垂直方向(図8(b)および図8(c)におけるZ方向)に隣り合うように形成され、かつ、基板10と平行方向(図8(b)および図8(c)におけるY方向)に延びるパターンが形成される。次いで、第1の実施の形態の配線形成方法における方法と同様の方法にて、図化工程を行なう。以上の工程により、図8(b)および図8(c)に示すように、隣り合う位置に複数の膜パターン(導電膜62および絶縁膜64)が形成される。

【0091】本実施の形態の配線形成方法によれば、複数の膜パターンを、基板10と垂直方向に隣り合う位置に形成することができる。特に、本実施の形態においては、複数の膜パターンが導電膜62および絶縁膜64からなり、絶縁膜64で覆われた導電膜62を液滴吐出法にて形成することができる。これにより、絶縁膜で保護された導電膜配線を、簡易な方法にて形成することができる。

【0092】[第7の実施の形態] 第7の実施の形態では、本発明を適用した非接触型カード媒体の一例について説明する。図9は、本実施の形態に係る非接触型カード媒体400を模式的に示す分解斜視図である。

【0093】(デバイスの構造) 本実施の形態に係る非接触型カード媒体400は図9に示すように、カード基体402とカードカバー418からなる筐体内に、半導体集積回路チップ408とアンテナ回路412とを内蔵し、図示されない外部の送受信機と電磁波または静電容量結合の少なくとも一方により電力供給あるいはデータ授受の少なくとも一方を行なうようになっている。

【0094】本実施の形態では、アンテナ回路412の一部(図9に示す領域1)が、第2実施形態に係る配線形成装置を用いて、第6実施形態に係る配線形成方法(図8参照)によって形成された導電膜配線からなる。すなわち、アンテナ回路412の領域1においては、導電膜62と、導電膜62を覆うように形成された絶縁膜64とから構成されている。アンテナ回路412におい

て領域1以外の部分は、導電膜62上に絶縁膜64が形成されていない。絶縁膜64は、アンテナ回路412のうち少なくとも一部上に配線が形成されている領域に形成される。

【0095】また、端子66、68は、配線65を介して電氣的に接続されている。この配線65の一部は、絶縁膜64上に形成されている。すなわち、配線65と導電膜62とは、絶縁膜64によって絶縁されている。この構成によれば、アンテナ回路412の一部を、第6の実施の形態の配線形成方法によって形成することにより、絶縁層を導電膜62の上に別設形成する工程を経ることなく、少なくとも上層の配線(配線65)と下層の配線(導電膜62)との絶縁性を確保したい箇所に、絶縁膜(絶縁膜64)を形成することができる。

【0096】(デバイスの製造方法) 次に、図10および図11に、本実施の形態に係る非接触型カード媒体400の製造方法の一例を示す。図10(a)および図11(a)はそれぞれ、図9に示す非接触型カード媒体の一製造工程を模式的に示す平面図である。また、図10(b)および図11(b)はそれぞれ、図10(a)および図11(a)のJ-Jにおける断面を模式的に示す断面図である。

【0097】まず、図10(a)および図10(b)に示すように、アンテナ回路412を構成する導電膜62を、第2の実施の形態の配線形成装置によって形成する。ここで、アンテナ回路412の一部(領域1)を、第6の実施の形態の配線形成方法と同様の方法を用いて形成する。これにより、アンテナ回路412の領域1において、導電膜62を覆うように絶縁膜64が形成される。アンテナ回路412において、領域1以外の部分は、導電膜62上に絶縁膜64が形成されない。

【0098】次いで、図11(a)および図11(b)に示すように、端子66、68を電氣的に接続する配線65を形成する。ここで、配線65の一部は、導電膜62の上方に絶縁膜64を介して形成される。以上の工程により、非接触型カード媒体400が得られる。

【0099】本実施の形態の非接触型カード媒体400によれば、アンテナ回路412の新線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、小型化および薄型化が可能な非接触型カード媒体とすることができる。

【0100】[第8の実施の形態] 第8の実施の形態では、本発明を適用した導電膜配線の一例について説明する。

【0101】図12は、本発明を適用した第8の実施の形態に係る導電膜配線を模式的に示す平面図である。なお、図12においては、配線間に形成された絶縁膜64(図13(c)参照)の図示は省略されている。図13(a)~図13(c)はそれぞれ、図12に示す導電膜配線の製造工程を模式的に示す断面図であり、それぞれ図12のF-Fに沿った断面に対応する。

【0102】本実施の形態においては、第6の実施の形態の配線形成方法によって得られる導電膜62および絶縁膜64を、半導体ICチップ80の再配置配線に適用した場合について説明する。

【0103】半導体ICチップ80には、図12に示すように、外縁部近傍に形成された端子82と、この端子82よりも内側に形成された再配置端子84とが形成されている。この端子82と再配置端子84とは、配線（導電膜配線）62によって電気的に接続されている。すなわち、この導電膜62が再配置配線として機能する。

【0104】次に、この半導体ICチップ80の製造方法について、図13(a)～図13(c)を参照して説明する。

【0105】まず、図13(a)に示すように、基板81の所定位置に、例えばアルミや金などの金属層からなる端子（パッド）82を形成した後、全面に、例えばポリミド樹脂からなる絶縁層83を形成する。次いで、絶縁層83において端子82の上部に相当する位置に開口部85を形成する。

【0106】次いで、図13(b)に示すように、第6の実施の形態の配線形成方法と同様の方法にて、第1の液滴62aと第2の液滴64aを吐出する。この工程において、後に再配置端子84が形成される位置には、第2の液滴64aを吐出しない。これにより、第2の液滴64aに開口部87が形成される。次いで、これらの液滴の溶媒等を除去して膜形成成分を固化し、導電膜62および絶縁膜64を形成する。

【0107】次いで、図13(c)に示すように、開口部87にボールバンプを形成する。このボールバンプは、開口部87の底面に露出した導電膜62と接続することにより、再配置端子84として機能する。以上の工程により、図12に示す半導体ICチップ80が得られる。

【0108】本実施の形態によれば、再配置端子84を形成する予定の箇所のみ第2の液滴64aを吐出しないことにより、絶縁膜64に開口部87を設ける。これにより、導電膜62の上に、直接再配置端子84を形成することができる。この結果、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ微細化された導電膜配線を得ることができる。

【0109】【第9の実施の形態】第9の実施の形態として、本発明の膜パターン形成方法の一例である導電膜配線形成方法について説明する。図14は、本発明を適用した第9の実施の形態に係る膜パターンの形成方法を模式的に示す断面図である。図15は、第9の実施の形態に係る膜パターンの形成方法の一形成工程を説明する図である。

【0110】本実施の形態においては、複数の液滴を、基板91に設けられた凹部96に吐出することにより、

複数の膜パターン（導電膜62および絶縁膜64）を凹部96に形成する場合について説明する。ここで、複数の膜パターン（導電膜62および絶縁膜64）は、基板91と垂直方向（図14に示すZ方向）に降り合うように形成することができる。

【0111】なお、本実施の形態に係る配線形成方法は、凹部96に複数の液滴を吐出する点以外は、第6の実施の形態に係る配線形成方法と同様である。本実施の形態において、具体的に、導電性微粒子を含む液状物（第1の液滴62a）と、絶縁体を含む液状物（第2の液滴64a）とを、ほぼ同一位置に重ねて凹部96に吐出する。その後、溶媒等を除去することにより膜形成成分を固化し、導電膜62と絶縁膜64とが、基板10と垂直方向（図14に示すZ方向）に降り合うように凹部96に形成される。

【0112】第1の液滴62aおよび第2の液滴64aはそれぞれ、第6の実施の形態の配線形成方法にて用いたものと同様の材質を用いることができる。この場合、第1の液滴62aの比重は、第2の液滴64aの比重よりも大きいことが望ましい。

【0113】第1の液滴62aおよび第2の液滴64aを凹部96に吐出した後、例えば図15に示すように、必要に応じて、基板91を遠心分離機にかけて、遠心力を付与することにより、第1の液滴62aおよび第2の液滴64aの分離を促進させることができる。この方法によれば、第1の液滴62aと第2の液滴64aとが容易に分離されて、短時間で膜質の均一化を図ることができる。

【0114】本実施の形態の配線形成方法によれば、第6の実施の形態の配線形成方法と同様の作用および効果を得ることができる。

【0115】【第10の実施の形態】第10の実施の形態では、本発明を適用した半導体装置の実装構造の一例について説明する。

【0116】（デバイスの構造）図16(a)は、本発明を適用した半導体装置の実装構造の一例たる第10の実施の形態に係るICチップ積層体70を模式的に示す断面図であり、図16(b)は、図16(a)の領域G部分の拡大模式図である。

【0117】第10の実施の形態に係るICチップ積層体70は、図16(a)に示すように、複数のICチップ70aが積層されることにより形成されている。なお、図16(a)では4枚のICチップ70aが積層されている場合を示しているが、ICチップ積層体70においてICチップ70aの積層枚数はこれに限定されるわけではない。

【0118】ICチップ70aはそれぞれ、表面に電子回路（図示せず）が形成されている。上下に降り合うICチップ70aは、コンタクト部76により電気的に接続されている。図16(b)は、このコンタクト部76

近傍の拡大模式図である。上下に隣り合うICチップ70a同士は、コンタクト部76を介して電気的に接続されている。

【0119】コンタクト部76は、導電膜62および絶縁膜64を含む。この導電膜62および絶縁膜64は基板71に設けられた凹部（開口部75）に形成されている。また、開口部75の側面には導電層77が設けられている。導電層77は、開口部75の下部で導電膜62と接続しており、かつ、開口部75の上部近傍で配線層73と接続している。したがって、導電膜62は導電層77を介して配線層73と電気的に接続されている。

【0120】また、隣り合うICチップ70aのコンタクト部76同士は、パッド78を介して電気的に接続されている。すなわち、下層のICチップ70aの導電層77および/または配線層73と、パッド78とが接続し、このパッド78と、上層のICチップ70aの導電層77および/または配線層73と接続することにより、下層のICチップ70aと上層のICチップ70aとが電気的に接続されている。

【0121】（デバイスの製造方法）次に、本実施の形態に係るICチップ積層体70の製造方法の一例を示す。図17（a）～図17（d）はそれぞれ、図16（a）に示すICチップ積層体70の製造方法における製造工程を示す断面図である。

【0122】まず、図17（a）に示すように、積層される複数のICチップ70aのうち、下層のICチップ70aの基板71の表面に、パッド78および接着材79を形成する。パッド78は、めっきや液滴吐出法にて形成される。

【0123】また、上層のICチップ70aに凹部（開口部75）を形成する。次いで、この開口部75の側面に、例えば金または銅からなる導電層73を形成し、さらに、この導電層73と接続する配線層77を形成する。なお、必要に応じて、導電層73を形成する前に、高融点金属層および/または高融点金属層の窒化物層、例えばTa、Ta<sub>2</sub>N、Ti、TiNからなるバリア層を形成することもできる。なお、この工程において、配線層77と導電層73の形成順序は特に限定されない。

【0124】次いで、図17（b）に示すように、下層ICチップ70aと上層のICチップ70aとを貼り合わせる。ここで、接着材79によって物理的接続が保たれる。なお、接着材79は機械的強度の要求の程度によっては、接着材79を用いることなく、下層のICチップ70aと上層のICチップ70aとを接続することもできる。次いで、第9の実施の形態に係る配線形成方法と同様の方法を用いて、液滴吐出法により、導電性微粒子を含む液状物（第1の液滴62a）と、絶縁体を含む液状物（第2の液滴64a）とを、ほぼ同一位置に重ねて開口部75に吐出する。その後、溶媒等を除去して膜形成成分を固化し、図17（c）に示すように、導電膜

62と絶縁膜64とが、基板71と垂直方向に隣り合うように開口部75に形成される。また、この工程の後、必要に応じて、前述した遠心分離工程を行なうこともできる。以上の工程により、コンタクト部76を形成する。

【0125】次いで、図17（d）に示すように、上層のICチップ70aの基板71上にパッド78を形成した後、さらに上層に別のICチップ70aを積層して、同様にコンタクト部76を形成する。以上の工程を経て、図16（a）および図16（b）に示すICチップ積層体70が得られる。

【0126】本実施の形態によれば、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ微細化されたICチップ積層体を得ることができる。

【0127】[第11の実施の形態] 第11の実施の形態として、本発明の膜パターン形成方法の一例について説明する。図18（a）～図18（d）はそれぞれ、本発明を適用した第11の実施の形態に係る膜パターンの形成方法によって形成された液滴を模式的に示す断面図である。

【0128】本実施の形態においては、第1の液滴112aと第2の液滴114aが互いに混ざり合わない性質を有する場合において、これらの液滴を、固化工程を経ずにはほぼ同一位置に重ねて吐出することによって、各液滴間の界面の状態を維持させた後、固化工程を行なうことにより、膜パターンを形成する例について説明する。なお、図18（a）～図18（d）においては、第1の液滴112aの比重が第2の液滴114aの比重よりも大きい場合について説明する。

【0129】図18（a）においては、第1の液滴112aの比重が第2の液滴114aの比重よりも大きいため、これらの液滴は層分離する結果、第2の液滴114aが第1の液滴112aよりも上層に配置される。なお、この場合、第1の液滴112aおよび第2の液滴114aを吐出する順序は特に限定されず、比重の重いほうを下層に配置される。

【0130】図18（b）においては、第1の液滴112aの比重が第2の液滴114aの比重よりも大きく、かつ、第2の液滴114aの吐出量が第1の液滴112aの吐出量よりもかなり多いため、第2の液滴114aが第1の液滴112aを覆うように形成される。

【0131】図18（c）においては、第1の液滴112aおよび第2の液滴114aが凹部116に形成されている。この場合においても、第1の液滴112aの比重が第2の液滴114aの比重よりも大きい。また、この例では、絶縁膜118に設けられた凹部116の底面116aは、第1の液滴112aに対して撥液性を有する処理が施されている。したがって、第1の液滴112aは第2の液滴114aよりも比重が大きいので、凹部116の底面116aの方へ移動しようとするが、底

面116aには第1の液滴112aに対して撥液性を有する処理が施されているため、第2の液滴114aの一部が底面116aに残る。また、凹部116の底面116aを液滴114aに対して親液性を有する処理を施すことによって同様の効果が得られる。これにより、図18(c)に示すように、第1の液滴112aが第2の液滴114aに挟まれ、いわゆるサンドイッチ構造が形成される。

【0132】例えば、図18(c)の構造において、第1の液滴112aとして絶縁体を含む液状物を用い、第2の液滴114aとして導電性微粒子を含む液状物を用いることができる。この場合、必要に応じて固化工程を行なった後最終的に得られる膜パターンは、2層の増電膜114と、この増電膜114によって挟まれた絶縁膜112とから構成される。この場合、この膜パターンは、例えばコンデンサとして機能することができる。

【0133】こうして、2層に分離させて目的の膜構造にした後に、自然放置、加熱、減圧などの方法を用いて溶媒（分散媒）を除去等して膜形成成分を固化することにより、目的とする膜パターンを形成する。

【0134】本実施の形態においては、分離様式は上述したものに限定されず、用いる液滴の比重、滴下量、および底面の液滴への親液性、撥液性をコントロールすることによって、任意に液滴の分離様式を制御することができる。また、先に吐出した液滴に含まれる液体成分が蒸発するのを防ぐため、基板または系全体を冷却しておくこともできる。さらに、上述した例では液滴の種類が2種類である場合について示したが、液滴の種類はこれに限定されるわけではなく、3種類以上でも良い。3種類の液滴を用いる場合に、例えば、それぞれの液滴に用いる溶媒（または分散媒）を、比重が重い無極性有機系液体、比重が中程度の水系液体、比重が軽い無極性有機系液体にすることにより、これらの液滴を吐出させて得られる3層を分離させることができる。

【0135】また、本実施の形態の膜パターンの形成方法によれば、得られた膜パターンを構成する膜の界面を外界に一度も露出させることなく形成することができるので、デバイスとしての特性を著しく向上させることができる。

【0136】〔第12の実施の形態〕第12の実施の形態では、本発明を適用した半導体装置の具体例について説明する。図19(a)は、半導体装置の一例たる本実施の形態に係る薄膜トランジスタ（TFT）120を模式的に示す平面図であり、図19(b)は、図19(a)に示すTFT120をH-IHにおける切断面を模式的に示す図である。

【0137】図19(a)に示すTFT120は、第11の実施の形態の膜パターンの形成方法を適用して形成される。このTFT120は、基板121の上に、例えば銀からなるゲート電極122が形成されている。この

ゲート電極122の上に、例えば酸化シリコンからなる絶縁層124が形成されている。この絶縁層124は、ゲート電極122とソース／ドレイン領域126、127とを絶縁するために設置されている。さらに、絶縁層124を覆うように、例えばアモルファスシリコンからなるチャネル領域125が形成されている。このチャネル領域125の上には、例えばドーパントシリコンからなるソース／ドレイン領域126、127が形成されている。さらに、このソース／ドレイン領域126、127の上に、ソース／ドレイン電極128、129が形成されている。

【0138】本実施の形態においては、ゲート電極122、ソース／ドレイン電極128、129、チャネル領域125、ソース／ドレイン領域126、127、および絶縁層124がいずれも、第11の実施の形態の膜パターンの形成方法によって形成されている。

【0139】本実施の形態においては、これらの層にそれぞれ含まれる液状物を、蒸発させて除去等して膜形成成分を固化することにより、各層を形成することができる。したがって、各層間の界面を、大気へ曝すことなく形成することができる。これにより、各層間の界面を良好な状態に形成することができる。この結果、各層の機能を高めることができる。

【0140】次に、このTFT120の製造方法の一例の実例について、図20(a)～図20(e)を参照して説明する。なお、本製造方法は一例であり、ここで示す材質以外の材質を用いて電極や絶縁層等を形成することができる。また、図20(a)～図20(e)において、左側の図は、本実施の形態のTFT120の一製造工程を模式的に示す平面図であり、図19(a)の平面図に対応する部分を示している。また、図20(a)～図20(e)において、右側の図は、左側の図の断面を示す図であり、図19(b)の断面図に対応する断面を示している。

【0141】まず、石英基板121とヘキサフルオロ1, 2, 2-テトラヒドロデシルトリエトキシラン0.1gとを、容積10リットルの密閉容器に入れて、120℃で2時間保持した。これにより、基板121の全面を撥液化した。次いで、マスクUV照射を行ない、ゲート電極を形成するために、幅10μmの親液パターン（図示せず）を形成した。次いで、液滴吐出法によって、この親液パターン上に、直径10nmの銀粒子が10wt%の割合で分散されている水分散液を、5p1ずつ30μmの間隔で吐出して、図20(a)に示すように、幅10μmで長さ1mmの塗布膜122aを形成した。

【0142】次いで、この塗布膜122aが乾かないように、ポリシラゼンの25wt%キシレン溶液を、別のインクジェットヘッドから、塗布膜122aが形成されている領域と同じ場所に向けて、10p1ずつ30μm

の間隙で吐出し、塗布膜124aを形成した。この工程により、図20(b)に示すように、塗布膜122aと、塗布膜122aの上に着弾させた塗布膜124aとが層分離を起こし、塗布膜124aが、塗布膜122aを完全に覆うような形で基板121上に定着した。この際、先に吐出した塗布膜122aが乾くのを遅らせるために、系全体を10℃に保ちながら系形成を行なったが、用いる溶媒によっては系全体を溶媒蒸気雰囲気下にするることによって、溶媒(分散媒)の蒸発を抑える方法をとることができる。なお、この工程において、配線接続用として、塗布膜122aの一部を露出させておいた(図20(c)参照)。

【0143】次に、この基板を20 Torrに減圧しながら80℃で30分間保持し、塗布膜122a中の水と、塗布膜124a中のキシレンとを完全に除去した後、大気圧中で350℃で10分間加熱した。これにより、図20(c)に示すように、銀がなるゲート電極122と、酸化シリコンからなる絶縁層124とが形成された。測定の結果、絶縁層124の膜厚は、60～80nmであった。

【0144】次いで、プラズマCVD法により、膜厚150nmのアモルファスシリコン膜(図示せず)を全面に形成した後、フォトリソグラフィ工程により、図20(d)に示すように、500μm四方のチャネル領域125を形成した。

【0145】次いで、シクロペンタシランを12wt%、黄リン1wt%を混合して溶解させたトルエン溶液20mlに、波長が254nmのUVを15分間照射した後透過して得た溶液を、液滴吐出法にて、チャネル領域125の上に吐出した。ここで、ゲート電極122直上に位置する部分に、10μmの隙間125aが形成されるように、前記溶液を吐出した(図20(e)参照)。次いで、基板121全体を400℃にて焼成することにより、図20(e)に示すように、ドーパントシリコンからなるソース/ドレイン領域126、127を形成した。

【0146】次いで、ゲート電極122の形成の際に用いたものと同じ銀分散液を用いて、液滴吐出法にて、ソース/ドレイン領域126、127にそれぞれ接するように、ソース/ドレイン電極128、129を形成した。以上の工程により、図19(a)および図19(b)に示すように、TFT120が得られた。

【0147】上記工程より得られたTFT120の電圧-電流特性を測定した結果、移動度0.3cm<sup>2</sup>/Vsのトランジスタとして動作した。

【0148】【第13の実施形態】第13の実施形態では、本発明を適用した電子機器の具体例について説明する。図21は、本実施形態に係る液晶装置の第1基板上の信号電極等の平面レイアウトを示す図である。

本実施形態に係る液晶装置は、この第1基板と、走査

電極等が設けられた第2基板(図示せず)と、第1基板と第2基板との間に封入された液晶(図示せず)とから概略構成されている。

【0149】図21に示すように、第1基板300上の画素領域303には、複数の信号電極310…が多重マトリクス状に設けられている。特に各信号電極310…は、各画素に対応して設けられた複数の画素電極部分310a…とこれらを多重マトリクス状に接続する信号配線部分310b…とから構成されており、Y方向に延伸している。

【0150】また、符号350は1チップ構造の液晶駆動回路で、この液晶駆動回路350と信号配線部分310b…の一端側(図中下側)とが第1引き回し配線331…を介して接続されている。

【0151】また、符号340…は上下導通端子で、この上下導通端子340…と、図示しない第2基板上に設けられた端子とが上下導通材341…によって接続されている。また、上下導通端子340…と液晶駆動回路350とが第2引き回し配線332…を介して接続されている。

【0152】本実施形態の液晶装置においては、画素電極部分310a…が、第12の実施形態に係る薄膜トランジスタ120からなる。

【0153】本実施形態の液晶装置によれば、画素電極部分310aが第12の実施形態に係る薄膜トランジスタ120からなることにより、製造が容易で、安価で、高速かつ安定した駆動が可能であり、かつ、小型化および薄膜化が可能な液晶装置とすることができる。

【0154】【第14の実施形態】第14の実施形態では、本発明を適用した発光装置の具体例について説明する。図22は、半導体装置の一例たる本実施形態に係る発光装置140を模式的に示す断面図である。

【0155】図22に示す発光装置140は、エレクトロルミネッセンス(EL)によって光を発する有機EL装置であり、基板141と、基板140上に形成された発光素子部140aを含む。発光素子部140aは、陽極143、陰極145、正孔輸送/注入層142、および発光層144を含む。また、陽極143の上には絶縁層148が形成され、この絶縁層148には開口部146が形成されている。この開口部146には、正孔輸送/注入層142および発光層144が形成されている。また、この正孔輸送/注入層142および発光層144は、陽極143および陰極145によって挟まれるように配置されている。

【0156】また、陽極143および陰極145によって一対の電極層が構成される。陽極143と陰極145との間に電圧を印加することにより、陽極143から正孔輸送/注入層142を経てホールが、陰極145から電子が、それぞれ発光層144に注入される。ここで、ホールと電子が発光層144内で結合することにより発

起子が生成され、この励起子が失活する際に光が生じる。

【0157】本実施の形態の発光装置によれば、正孔輸送/注入層142および発光層144は、第11の実施の形態の膜パターンの形成方法を適用して形成することができる。この場合、正孔輸送/注入層142と発光層144とは、蒸着吐出法により、正孔輸送/注入層142を構成する成分を含有する液状物（第1の液滴142a）と、発光層144を構成する成分を含有する液状物（第2の液滴144a）とを、連続して吐出する工程を経て形成される。すなわち、液滴吐出法により、第1の液滴142aと第2の液滴144aとを吐出した後、これらの液滴に含まれる溶媒を蒸発させて同時に除去することができる。このため、溶媒除去時に、正孔輸送/注入層142と発光層144との界面が露出して、大気に曝露することはない。したがって、正孔輸送/注入層142と発光層144との界面の状態を非常に良好に保つことができる。これにより、正孔輸送/注入層142と発光層144との界面が均質に形成されたため、該界面における電荷の移動性を確保することができる。その結果、得られた発光装置の特性を著しく向上させることができる。

【0158】次に、この発光装置140の製造方法の一実施例について、図23(a)～図23(c)および図24(a)～図24(c)を参照して説明する。なお、本製造方法は一例であり、ここで示す材質以外の材質を用いて電極や発光層等を形成することができる。

【0159】（実験例）まず、図23(a)に示すように、基板141上に、ITOからなる陽極143を形成した。次いで、図23(b)に示すように、陽極143の上に、ポリイミド樹脂からなる厚膜2μmの絶縁層148を形成した。この絶縁層148には、直径30μm、ピッチ40μmにて形成された開口部146が形成されている。この開口部146は、後述する工程において、正孔輸送/注入層142および発光層144を形成するために設けられている。次いで、この基板141に対して、酸素プラズマおよびフッ素ガスプラズマの連続処理を行い、図23(c)に示すように、絶縁層148の表面を酸液化するともに、露出している陽極143の表面（開口部146の底面146a）を酸液化した。すなわち、この工程においては、図23(c)に示すように、絶縁層148の表面のみを酸液化する。すなわち、この工程により、絶縁層148の表面に酸液パターン147が形成され、開口部146の底面146aに親液パターンが形成される。

【0160】次いで、PEPOT（ポリエチレンジオキシシチオフェン）／PSS（ポリスチレンスルホン酸）（パイロトン／水分散液）：8wt%、水81.5wt%、メタノール5.5wt%、イソプロピルアルコール5wt%、γ-グリニジルオキシプロピストリメチキ

シラン0.05wt%を混合した溶液を、開口部146に向かって10pL吐出して、図24(a)に示すように、開口部146に第1の液滴142aを形成した。

【0161】次いで、この第1の液滴142aが蒸発する前に、別のインクジェットヘッドにて、PPV（ポリパラフェニレンビニレン）2wt%、メタノール20wt%、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノール7wt%、ブチルカルビトールアセテート8wt%を混合した溶液を、第1の液滴142aの上に8pL吐出して、図24(b)に示すように、第1の液滴142a上に第2の液滴144aを形成した。この第1の液滴142aと第2の液滴144aとはそれぞれ層分離していた。

【0162】次いで、真空中（1torr）、150℃で4時間処理を行ない、第1の液滴142aおよび第2の液滴144aから溶媒を完全に除去して膜成分を固化し、図24(c)に示すように、正孔輸送/注入層142および発光層144を形成した。

【0163】次いで、真空加熱蒸着によって、正孔輸送/注入層142の上に、膜厚50nmのCa層145aと、膜厚200nmのAl層145bとを形成した。これにより、図22に示すように、Ca層145aおよびAl層145bからなる陰極145が形成された。続いて、電極保護用のアクリル樹脂（図示せず）で封止を行った。以上の工程により、図22に示す発光装置140が得られた。

【0164】上記工程により得られた発光装置140の発光特性を測定した結果、駆動電圧は5Vで、輝度120cd/m<sup>2</sup>、発光寿命（輝度半減時間）は3000時間であった。

【0165】上記実験例によれば、発光特性に優れた発光装置を得ることができた。

【0166】また、上記実験例によれば、複数の膜パターン（正孔輸送/注入層142および発光層144）を形成したい領域（開口部146の底面146a）に親液パターンを形成し、前記複数の膜パターンの形成を望まない領域（絶縁層148の表面）に、撥液パターン147を形成した後、第1および第2の液滴142a、144aを吐出する。これにより、第1および第2の液滴142a、144aを所望の領域に形成することができる。この結果、複数の膜パターン（正孔輸送/注入層142および発光層144）を所望の領域に選択的に形成することができるため、所望の形状の膜パターンを所望の位置に形成することができる。

【0167】（比較例）一方、比較例として、第1の液滴142aを開口部146の底面146aに着弾させた後に第1の液滴142aに含まれる溶媒を完全に除去して膜成分を固化してから、第2の液滴144aを吐出させることにより、発光装置を形成した。具体的には、上記実験例と同様に、基板141上に陽極143および絶縁層148を形成した後に、第1の液滴142



aを開口部146の底面146aに着弾させた。次いで、この比較例では、真空中(1torr)、150℃で2時間処理して、第1の液滴142a中に含まれる溶媒を除去して膜形成成分を固化した後に、第2の液滴144a上に第1の液滴142aを吐出し、その後、さらに、真空中(1torr)、150℃で2時間処理して、第2の液滴144a中に含まれる溶媒を除去して膜形成成分を固化した。後の工程は、上記実施例1と同様に発光装置(図示せず)を作成した。その結果、駆動電圧は8Vで、輝度85cd/m<sup>2</sup>、発光寿命(輝度半減時間)は2000時間であった。すなわち、比較例の発光装置は、実施例の発光装置より高い駆動電圧を印加しても、輝度が低いうえに、発光寿命が短かった。

【0168】以上の結果により、上記実施例の発光装置は、第1および第2の液滴142a、144aに含まれる溶媒の除去を同時に行なうことにより膜形成成分を固化したため、正孔輸送/注入層142と発光層144との界面が露出することなく、正孔輸送/注入層142および発光層144が形成された。このため、正孔輸送/注入層142と発光層144との界面が良好な状態となるため、前記界面における電荷の移動性が良好となる。その結果、得られた発光装置の特性を著しく向上させることができた。

【0169】【第15の実施の形態】第13の実施の形態では、本発明を適用した電子機器の具体例について説明する。本実施の形態に電子機器は、第13の実施の形態に係る液晶装置または第14の実施の形態に係る発光装置からなる表示部(後述する)を備える。

【0170】図25(a)は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図25(a)において、600は携帯電話本体を示し、601は第13の実施の形態に係る液晶装置または第14の実施の形態に係る発光装置を備えた表示部を示している。

【0171】図25(b)は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図25(b)において、700は情報処理装置、701はキーボードなどの入力部、703は情報処理装置本体、702は第13の実施の形態に係る液晶装置または第14の実施の形態に係る発光装置を備えた表示部を示している。

【0172】図25(c)は、時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図25(c)において、800は時計本体を示し、801は第13の実施の形態に係る液晶装置または第14の実施の形態に係る発光装置を備えた表示部を示している。

【0173】図25(a)～図25(c)に示す電子機器は、上記実施形態の液晶装置または発光装置を備えたものであるため、高速かつ安定した駆動が可能であり、かつ、小型化および薄体化が可能となる。

【0174】なお、本実施の形態の電子機器として、上

述したもののほかに、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、ICカード、ミニディスクプレーヤ、タッチパネルを備えた機器等が例示できる。そして、これらの各種電子機器の表示部として、上述した表示部が適用可能であるのは言うまでもない。

【0175】本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成(例えば、機能、方法および結果が同一の構成、あるいは目的および結果が同一の構成)を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を加えた構成を含む。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した第1の実施の形態に係る膜パターンの形成方法を模式的に示す断面図である。

【図2】第1の実施の形態に係る膜パターンの形成方法によって形成された膜パターンを模式的に示す平面図である。

【図3】本発明を適用した第2の実施の形態に係る膜パターン形成装置を模式的に示す斜視図である。

【図4】本発明を適用した第3の実施の形態に係る導電膜配線を模式的に示す平面図である。

【図5】図5(a)は、図4に示す領域Bの拡大模式図であり、図5(b)は、図5(a)のC-Cに沿った断面を模式的に示す図である。

【図6】図6(a)～図6(d)はそれぞれ、本発明を適用した第4の実施の形態に係る導電膜配線の一製造工程を模式的に示す断面図である。

【図7】本発明を適用した第5の実施の形態に係る半導体装置の装填構造を模式的に示す断面図である。

【図8】図8(a)および図8(b)は、本発明を適用した第6の実施の形態に係る膜パターンの形成方法を説明する図であり、図8(c)は、第6の実施の形態に係る膜パターンの形成方法によって形成された膜パターンを模式的に示す平面図である。

【図9】本発明を適用した第7の実施の形態に係る非接触型カード媒体を模式的に示す分解斜視図である。

【図10】図10(a)は、図9に示す非接触型カード媒体の一製造工程を模式的に示す平面図であり、図10(b)は、図10(a)のJ-Jにおける断面を模式的に示す図である。

【図11】図11(a)は、図9に示す非接触型カード媒体の一製造工程を模式的に示す平面図であり、図11(b)は、図11(a)のJ-Jにおける断面を模式的に示す図である。

【図 12】本発明を適用した第 8 の実施の形態に係る導電配線を模式的に示す平面図である。

【図 13】図 13 (a) ～図 13 (c) はそれぞれ、図 12 に示す導電配線の一製造工程を模式的に示す断面図である。

【図 14】本発明を適用した第 9 の実施の形態に係る膜パターンの形成方法を模式的に示す断面図である。

【図 15】本発明を適用した第 9 の実施の形態に係る膜パターンの形成方法の一形成工程を説明する図である。

【図 16】図 16 (a) は、本発明を適用した第 10 の実施の形態に係る半導体装置の実装構造を模式的に示す断面図であり、図 16 (b) は、図 16 (a) の領域 G の拡大模式図である。

【図 17】図 17 (a) ～図 17 (d) はそれぞれ、図 13 に示す半導体装置の実装構造の一製造工程を模式的に示す断面図である。

【図 18】図 18 (a) ～図 18 (d) はそれぞれ、本発明を適用した第 11 の実施の形態に係る膜パターンの形成方法によって形成された液滴を模式的に示す断面図である。

【図 19】図 19 (a) は、本発明を適用した半導体装置の一例たる第 12 の実施の形態に係る薄膜トランジスタを模式的に示す平面図であり、図 19 (b) は、図 19 (a) の H-H における断面を模式的に示す図である。

【図 20】図 20 (a) ～図 20 (e) はそれぞれ、図 19 に示す薄膜トランジスタの一製造工程を模式的に示す平面図および断面図である。

【図 21】本発明を適用した電気光学装置の一例たる第 13 の実施の形態に係る液晶装置の第 1 基板を模式的に示す平面図である。

【図 22】本発明を適用した発光装置の一例たる第 14 の実施の形態に係る発光装置を模式的に示す断面図である。

【図 23】図 23 (a) ～図 23 (c) はそれぞれ、図 22 に示す発光装置の一製造工程を模式的に示す断面図である。

【図 24】図 24 (a) ～図 24 (c) はそれぞれ、図 22 に示す発光装置の一製造工程を模式的に示す断面図である。

【図 25】図 25 (a) は、本発明を適用した電子機器の一例たる第 15 の実施の形態に係る携帯電話を示す図であり、図 25 (b) は、本発明を適用した電子機器の一例たる第 15 の実施の形態に係る携帯型情報処理装置を示す図であり、図 25 (c) は、本発明を適用した電子機器の一例たる第 15 の実施の形態に係る腕時計型電子機器を示す図である。

【図 26】第 1 の実施の形態の膜パターンの形成方法を説明するフローチャートである。

【図 27】一般的な膜パターンの形成方法を説明するフ

ローチャートである。

【符号の説明】

1 インクジェットヘッド群

2 X 方向ガイド軸

3 X 方向駆動モータ

4 載置台

5 Y 方向ガイド軸

6、16 Y 方向駆動モータ

7 基台

8 制御装置

10 基板

11、11a、11b ノズル

12 インクジェットヘッド

14 クリーニング機構部

15 ヒータ

18a、18b インクタンク

22 導電膜

22a 第 1 の液滴

24 絶縁膜

24a 第 2 の液滴

30 半導体 IC チップ

31 基板

32 再配置端子

34 端子

40 プリント基板

41 ベース基板

42 導電層

50 CPU 搭載基板

52、53 ボールパンブ

54 カバー

56 緩衝材

58 CPU

62 導電膜

62a 第 1 の液滴

64 絶縁膜

64a 第 2 の液滴

65 配線

66、68 端子

70 IC チップ積層体

70a IC チップ

71 基板

72 ヘッド

73 導電層

74 ボールパンブ

75 開口部

76 コンタクト部

77 配線層

78 パッド

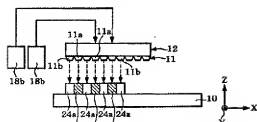
79 接着材

80 半導体 IC チップ

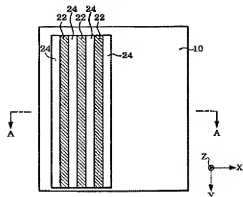
8 1 基板  
 8 2 端子  
 8 3 絶縁層  
 8 4 再配置端子  
 8 5, 8 7 開口部  
 8 9 補強材  
 9 1 基板  
 9 6 凹部  
 1 0 0 配線形成装置  
 1 1 2 導電膜  
 1 1 2 a 第1の液滴  
 1 1 4 絶縁膜  
 1 1 4 a 第2の液滴  
 1 1 6 凹部  
 1 1 8 絶縁層  
 1 2 0 薄膜トランジスタ (TFT)  
 1 2 1 基板  
 1 2 2 ゲート電極  
 1 2 2 a 塗布膜  
 1 2 4 絶縁層  
 1 2 4 a 塗布膜  
 1 2 5 チャンネル領域  
 1 2 5 a 隙間  
 1 2 6, 1 2 7 ソース/ドレイン領域  
 1 2 8, 1 2 9 ソース/ドレイン電極  
 1 4 0 発光装置  
 1 4 0 a 発光素子部  
 1 4 1 基板  
 1 4 2 正孔輸送/注入層  
 1 4 2 a 第1の液滴  
 1 4 3 陽極

1 4 4 発光層  
 1 4 4 a 第2の液滴  
 1 4 5 陰極  
 1 4 6 開口部  
 1 4 6 a 開口部の底面 (親液パターン)  
 1 4 7 撥液パターン  
 1 4 8 絶縁層  
 1 4 9 電源  
 3 0 0 第1基板  
 3 0 3 画素領域  
 3 1 0 信号電極  
 3 1 0 a 画素電極部分  
 3 1 0 b 信号配線部分  
 3 3 1 第1引き出し配線  
 3 3 2 第2引き出し配線  
 3 4 0 上下導通端子  
 3 4 1 上下導通材  
 3 5 0 液晶駆動回路  
 4 0 0 非接触型カード媒体  
 4 0 2 カード基板  
 4 0 8 半導体集積回路チップ  
 4 1 2 アンテナ回路  
 4 1 8 カードカバー  
 6 0 0 携帯電話本体  
 6 0 1 表示部  
 7 0 0 情報処理装置  
 7 0 1 入力部  
 7 0 2 表示部  
 7 0 3 情報処理装置本体  
 8 0 0 時計本体  
 8 0 1 表示部

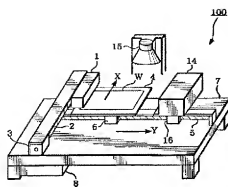
【図1】



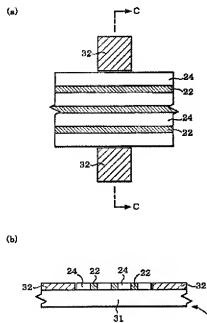
【図2】



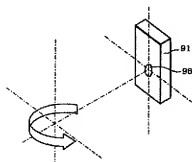
【図3】



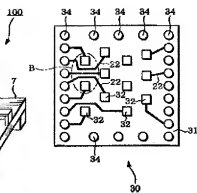
【図5】



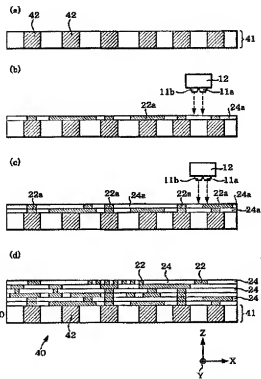
【図15】



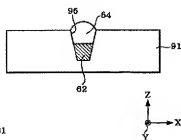
【図4】



【図6】

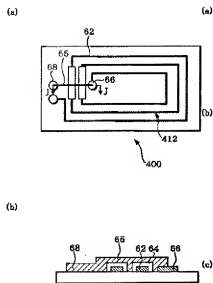


【図14】

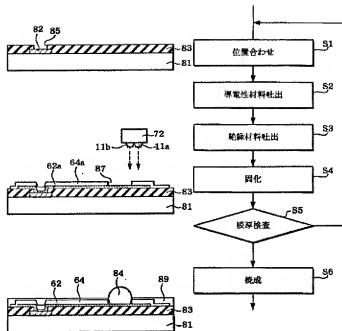




【圖 11】

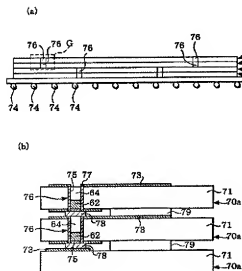


【圖 13】

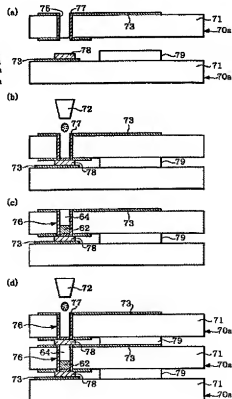


【圖 26】

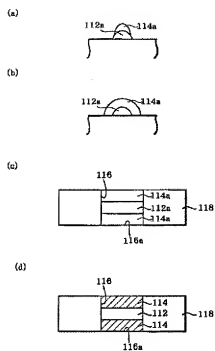
【圖 16】



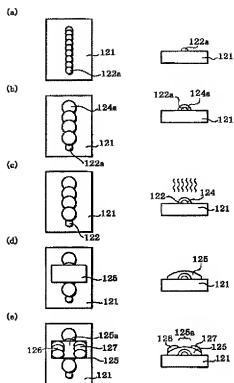
【圖 17】



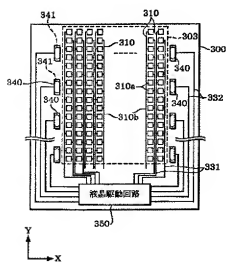
【図18】



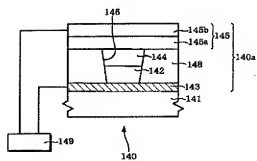
【図20】



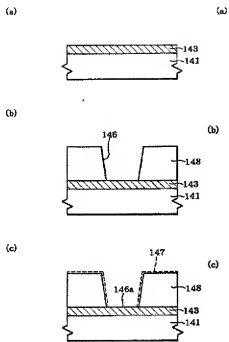
【図21】



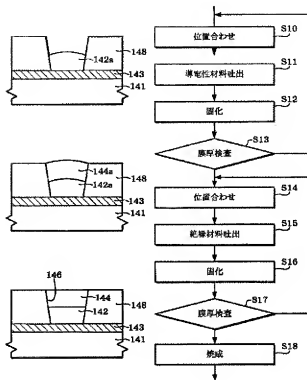
【図22】



【圖 2 3】



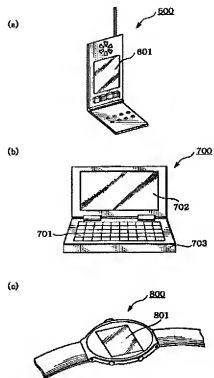
【圖 2 4】



【圖 2 7】



【図 25】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I  
H 0 1 L 29/78

サーチコード\* (参考)

6 2 7 C  
6 1 7 V

(72) 発明者 青木 敬

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ  
ーエブソン株式会社社内

F ターム(参考) 4M104 AA01 EB01 EB02 BB04 BB05  
BB07 BB08 BB09 BB36 CC01  
CC05 DD20 DD51 DD78 DD80  
DD81 EE09 EE14 EE17 EE18  
FF13 GG09 GG10 GG14 GG20  
HH13 HH14 HH20  
5F033 HH00 HH04 HH07 HH11 HH13  
HH14 HH40 JJ00 JJ01 JJ07  
JJ11 JJ13 JJ14 KK05 KK08  
KK13 MM05 PP26 QQ09 QQ37  
QQ53 QQ73 QQ82 QQ83 RR04  
RR21 RR22 SS30 VV07 VV15  
XX00 XX02 XX03 XX31  
5F045 AB32 BB08 EB19 HA16  
5F110 AA16 BB02 CC07 DD03 EE02  
EE41 EE42 EE47 EE48 FF02  
FF21 FF27 FF36 GG02 GG15  
GG24 GG45 HK02 HK09 HK21  
HK25 HK32 HM20 NN72 QQ01  
QQ08